

量産モジュールテスト

ATLAS-J silicon workshop

広島大学 岩田

0. pre-assemble test

mount & wire-bond chips,
electrical test

1. spec test

spec を満たすか？

モジュール組み立て直後のテスト

electrical & mechanical

@25 (20), 60%(humidity)

項目

@浜松 DAQ 動作テスト

threshold scan

bias scan

dark current

@KEK signal (laser?)

装置

TEST STAND 2台

1台@浜松

組み立て速度：3 modules/day

6 modules 同時測定

1台@KEK for signal test

測定顕微鏡

2. heat cycle

-30 ~ +50

cycle 後測定 electrical & distortion

POWER ON?

時間：熱平行になる時間？

項目

装置

TEST STAND

恒温槽

高温...・湿度コントロール可

低温...・湿度コントロール不可

N₂ flow 接地必要

測定顕微鏡

3. burn-in test

hybrid@50 , humidity 60%
electrical test

項目

継続時間： 24時間

時間間隔

装置

TEST STAND

恒温槽

4. テスト結果の database

5. UK と統一？

テストの方法、項目、database：

UK と統一すべし

打ち合わせ、マニュアル必要

6. 人員

staff KEK: 海野、氏家、寺田、池上
大学: 原、高嶋、岩田

非常勤を雇うか？ 努力はする。

学生 人数、期間？